

# EPTA Member List

2014.4

	name	carrier	specialty
代表	橋本薫	富士通, JIEP, 明星大	実装技術, はんだ技術
理事	和田毅	沖電気, 沖セラミックス, ESL日本	電子部品, セラミックス, ペースト
理事	宮代文夫	東芝, 東芝ケミカル, PI技研	マイクロ波, SAWデバイス
理事	傳田 精一	産総研, サンケン電気, コニカ	半導体, 実装技術
理事	西田秀行	IBM, 三星, NETech	実装技術, フリップチップ
理事	田畑晴夫	日東電工, ローム, 大阪大	高分子合成, 物性, 半導体パッケージ
	山瀬英夫	チッソ, 浜松ホトニクス, 嘉昌電子	シリコン結晶, エピタキシャル
	高田清司	信越半導体	シリコン結晶
	安原光	フジクラ	ケーブル, 半導体パッケージ
	国岡昭夫	青山学院大, 大東文化大	半導体デバイス
	相良岩男	沖電気, KOA	半導体応用回路
	遠藤正徳	東北金属, 藤倉化成	フェライト, 導電ペースト
	高木清	富士通	プリント基板
	藤江明雄	NEC, カイジョー	半導体, 静電気対策
	林秀臣	フジクラ, 東大	フレキシブル実装, エコデザイン
	大西哲也	シャープ, GJTech	実装技術, 半導体チップ
	狛豊	デイスコ, 理研	ウエハ切断, 研磨技術
	堀家尚文	三洋化成, サンノプロ	ケミカル材料
	鴨志田元孝	NEC, トーキン, 武田財団	ウエハプロセス
	加藤凡典	大日本印刷, AiT	実装技術評論
	塚田裕	IBM, 京セラ, i-PACKS	パッケージ, 基板, バンプ
	岡本明	TDK	フェライト
	津田英隆	富士通	データ解析
	井上和夫	シチズン, JSR, Amat	実装材料
	中島信哉	龍森	樹脂ファイラー
	福岡義孝	東芝, ウエイステイ	実装技術, 基板技術
	手塚佳夫	松下電器, 鈴木, 長野県工科短大	機械設計, 実装技術
	湯之上隆	日立, エルピーダ, 微細加工研究所	半導体微細加工, 半導体評論